

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

公告编号：2026-039

鸿合科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次投资属于公司向半导体业务板块的转型投资，半导体相关业务与原有主业存在较大差异，公司存在跨行业投资、经营、管理的风险。

此外，全资子公司的设立尚需当地行政主管部门审核，可能存在因各种因素导致不达预期的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

1、鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化业务布局、推动新兴业务的发展，拟以自有资金人民币 60,000.00 万元设立全资子公司鸿合半导体有限公司（暂定名，具体以当地行政主管部门核准登记的名称为准，以下简称“标的公司”）。

公司设立半导体业务平台，依托控股股东在整车产业链、应用场景及产业资源方面的积累，围绕车用半导体相关领域开展业务探索和产业布局。公司将结合自身发展规划，充分发挥产业协同优势，加强与相关合作方的沟通协作，推动业务稳健发展。

2、公司于 2026 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未达股东会审议标准。本次对外投资设立全资子公司不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：鸿合半导体有限公司（暂定名，具体以当地行政主管部门核准登记的名

称为准)

公司性质：有限责任公司

注册资本：人民币 60,000.00 万元

法定代表人：姚瑞波

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区

经营范围：集成电路、电子元器件、半导体芯片、半导体分立器件、汽车电子产品的研发、制造、销售，微电子技术领域内的技术咨询、技术服务；电气机械设备的研发及销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有资金从事投资活动。经营范围以最终市场监督管理部门登记范围为准。

出资额及持股比例：公司拟出资人民币 60,000.00 万元，持有 100%股权

资金来源及出资方式：公司自有现金资金

以上公司基本信息具体以当地行政主管部门核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司出资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、交易目的

本次公司对外投资设立子公司，是基于公司整体发展战略和经营需要，优化业务布局、推动新兴业务的发展，进一步提升公司整体运营效率与市场竞争力。

2、对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司自有资金，符合公司战略规划及经营发展的需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、存在的风险

1) 本次投资属于公司向半导体业务板块的转型投资，半导体相关业务与原有主业

存在较大差异，可能面临人员、技术、管理壁垒，市场前景发生变化等风险因素，公司存在跨行业投资、经营、管理的风险；

2) 标的公司的设立尚需当地行政主管部门审核或备案，可能存在因各种因素导致不达预期的风险，公司的投资收益存在一定的不确定性；

3) 半导体行业的需求与下游终端应用领域行业的景气度密切相关，若未来半导体行业下游终端应用领域行业的市场需求出现衰减，将导致经营业绩出现波动；

4) 下游行业的快速发展与国产替代需求的日益增大将鼓励更多企业进入，如果标的公司技术研发进度不达预期，则面临市场竞争加剧及业务拓展受阻的风险。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第三届董事会战略委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司

董事会

2026年7月23日